

IL DIRIGENTE

Oggetto: Accordo quadro di Ateneo, suddiviso in 3 lotti, per la fornitura in acquisto di server ad alte prestazioni nonché componenti e servizi accessori connessi ed opzionali per le esigenze dei progetti di ricerca dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna – rettifica del Capitolato Tecnico

- Visto** il proprio precedente provvedimento rep. n. 7774/2023 prot. 376646 del 14.12.2023 con cui sono stati approvati la relazione tecnica illustrativa e allegato Quadro economico, il Capitolato, e il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) relativi alla procedura in oggetto;
- Visto** il provvedimento della dirigente dell'Area Appalti e Approvvigionamenti rep. 2037/2023, prot. 0376840 del 14.12.2023 di indizione ed espletamento di una procedura telematica aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, suddivisa in 3 lotti, per l'affidamento di un Accordo quadro di Ateneo con un operatore economico ai sensi dell'art. 59 c. 3 del D. Lgs. 36/2023, per la fornitura in acquisto di server ad alte prestazioni nonché componenti e servizi accessori connessi ed opzionali per le esigenze dei progetti di ricerca dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna per un valore massimo complessivo presunto dell'appalto (comprensivo di ogni eventuale opzione) pari a € 10.776.568,19 (IVA esclusa);
- Preso atto** della necessità di chiarire alcune specifiche tecniche e correggere alcuni refusi nell'ottica di favorire la massima partecipazione dei concorrenti, senza rinunciare agli elevati standard qualitativi dei prodotti richiesti per soddisfare le esigenze computazionali dei progetti di ricerca dell'Università di Bologna, come da nota del RUP, dott. Marco Rubboli, di seguito allegata;
- Visto** il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- Richiamato** l'art. 32 dello Statuto di Ateneo;
- Richiamato** il Provvedimento del direttore Generale rep. 4563/2020 Prot. n. 149943 del 27.07.2020 di attribuzione di incarico di funzione di Dirigente dell'Area Sistemi e Servizi Informatici – CESIA all'ing. Enrico Lodolo;

DISPONE

Art. 1 – rettificare il Capitolato Tecnico come di seguito descritto:

- Par. 4.3 Caratteristiche tecniche minime comuni alle apparecchiature dei lotti 1, 2, 3, punto e:
Versione precedente: *“essere equipaggiate di controller (integrato o aggiuntivo su bus PCI) di dischi interni SAS/NVME in base alla tipologia successivamente indicata nei componenti opzionali, con funzionalità hardware RAID almeno 0, 1, 5. La funzionalità*

RAID, ovvero il controller RAID fornito in configurazione base, deve poter gestire la quantità di dischi massima installabile e dichiarata;”

Versione rettificata: *“essere equipaggiate di controller (integrato o aggiuntivo su bus PCI) di dischi interni SAS/NVME in base alla tipologia successivamente indicata nei componenti opzionali, con funzionalità hardware o software RAID almeno 0, 1, 5. La funzionalità RAID, ovvero il controller RAID fornito in configurazione base, deve poter gestire la quantità di dischi massima installabile e dichiarata;”*

- Par. 4.3 Caratteristiche tecniche minime comuni alle apparecchiature dei lotti 1, 2, 3, punto f:

Versione precedente: *“essere forniti e comprensivi di alimentatori la cui efficienza sarà almeno come di seguito indicata:*

- *Se al 20% del carico almeno 90%;*
- *Se al 50% del carico almeno 94%;*
- *Se al 100% del carico almeno 91%.*

Tali valori sono corrispondenti almeno al livello 80 PLUS Platinum, così come definita al par. 3.6 delle procedure di test previste nell'EPRI Generalized Internal Power Supply Efficiency Test Protocol (disponibile sul sito www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx);”

Versione rettificata: *“essere forniti e comprensivi di alimentatori la cui efficienza sarà almeno come di seguito indicata:*

- *Se al 10% del carico almeno 90%;*
- *Se al 20% del carico almeno 94%;*
- *Se al 50% del carico almeno 96%;*
- *Se al 100% del carico almeno 91%.*

Tali valori sono corrispondenti almeno al livello 80 PLUS Titanium, così come definita al par. 3.6 delle procedure di test previste nell'EPRI Generalized Internal Power Supply Efficiency Test Protocol (disponibile sul sito www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx);”

- Par. 4.4 Caratteristiche tecniche minime per le apparecchiature del lotto 1 - Server dual socket HIGH CPU, punto 5:

Versione precedente: *“Il server dovrà essere fornito in configurazione ibrida (ovvero una configurazione dell'apparecchiatura con dischi e/o memorie miste, che possa includere contemporaneamente dischi rotazionali e memorie flash). Le memorie flash potranno essere o di tipo SSD o di tipo NVME.”*

Versione rettificata: *“Il server dovrà essere fornito in configurazione ibrida (ovvero una configurazione dell'apparecchiatura che possa includere dischi di tipo SSD o di tipo NVME).”*

- Par. 4.5 Caratteristiche tecniche minime per le apparecchiature del lotto 2 - Server dual socket GPU ad alte prestazioni, punto 6:
Versione precedente: *“Il server dovrà essere fornito in configurazione ibrida (ovvero una configurazione dell'apparecchiatura con dischi e/o memorie miste, che possa includere contemporaneamente dischi rotazionali e memorie flash). Le memorie flash potranno essere o di tipo SSD o di tipo NVME.”*
Versione rettificata: *“Il server dovrà essere fornito in configurazione ibrida (ovvero una configurazione dell'apparecchiatura che possa includere dischi di tipo SSD o di tipo NVME).”*

- Par. 4.6 Caratteristiche tecniche minime per le apparecchiature del lotto 3 - Server dual socket EXTREME GPU, punto 6:
Versione precedente: *“Il server dovrà essere fornito in configurazione ibrida (ovvero una configurazione dell'apparecchiatura con dischi e/o memorie miste, che possa includere contemporaneamente dischi rotazionali e memorie flash). Le memorie flash potranno essere o di tipo SSD o di tipo NVME.”*
Versione rettificata: *“Il server dovrà essere fornito in configurazione ibrida (ovvero una configurazione dell'apparecchiatura che possa includere dischi di tipo SSD o di tipo NVME).”*

- Par. 4.5 Caratteristiche tecniche minime per le apparecchiature del lotto 2 - Server dual socket GPU ad alte prestazioni, punto 9:
Versione precedente: *“Il server dovrà essere dotato di un sottosistema di I/O PCIe Gen5 o superiore e dovranno garantire il numero di slot di espansione liberi indicati, al netto dei componenti necessari per il rispetto degli altri requisiti: 4”.*
Versione rettificata: *“Il server dovrà essere dotato di un sottosistema di I/O PCIe Gen5 o superiore e dovrà garantire il numero di slot di espansione liberi ed utilizzabili indicati, al netto dei componenti necessari per il rispetto degli altri requisiti: 1”.*

- Par. 4.6 Caratteristiche tecniche minime per le apparecchiature del lotto 3 - Server dual socket EXTREME GPU, punto 9:
Versione precedente: *“Il server dovrà essere dotato di un sottosistema di I/O PCIe Gen5 o superiore e dovranno garantire il numero di slot di espansione liberi indicati, al netto dei componenti necessari per il rispetto degli altri requisiti: 4”.*
Versione rettificata: *“Il server dovrà essere dotato di un sottosistema di I/O PCIe Gen5 o superiore e dovrà garantire il numero di slot di espansione liberi ed utilizzabili indicati, al netto dei componenti necessari per il rispetto degli altri requisiti: 1”.*

- Par. 6.2 Caratteristiche tecniche dei componenti opzionali - par. 6.2.1 – Componenti Opzionali Lotti 1,2,3, punto 8:

Versione precedente: *“Unità memoria interna aggiuntiva di tipo NVME Mixed Use di 7,68TB o superiore Endurance DWPD ≥ 3.0 ”.*

Versione rettificata: *“Unità memoria interna aggiuntiva di tipo NVME Read Intensive “hot swap” di 7.68TB o superiore Endurance DWPD ≥ 0.9 ”.*

Art. 2: di approvare il testo del Capitolato tecnico rettificato come di seguito allegato.

Il Dirigente dell'Area Sistemi e Servizi Informatici
(CESIA)
Ing. Enrico Lodolo
(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e
s.m.i)

ALLEGATI INTEGRANTI DEL DECRETO

1. Nota tecnica del RUP
2. Rettifica Capitolato Tecnico